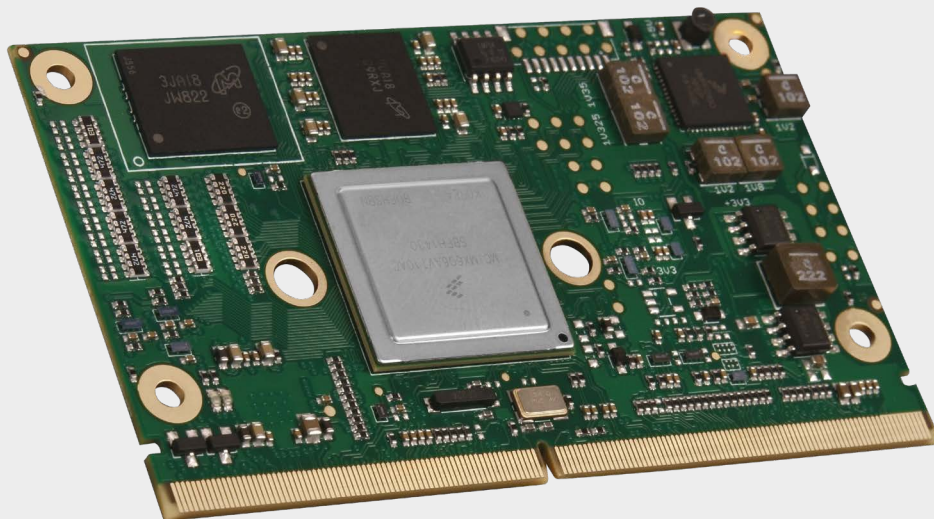


i.MX 6

Low-Power Embedded Architektur Plattform





i.MX 6

Das ultra energiesparsame Computer-on-Module bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Skalierbare Building Blocks ermöglichen maßgeschneiderte mobile und vernetzte Embedded Lösungen basierend auf ARM Technologie.

Key Features



Freescale i.MX 6 (Single, Dual, Quad Core, 800 MHz bis 1,2 GHz)



Bis zu 4 GB DDR3 Memory



On-Board 10/100/1000 Mbit LAN



**Vielzahl an Schnittstellen,
z. B. 3x USB 2.0, 3x PCIe**



Erweiterbarer Temperaturbereich



Evaluation Board on-demand

Skalierbare Leistung und kompakter Formfaktor

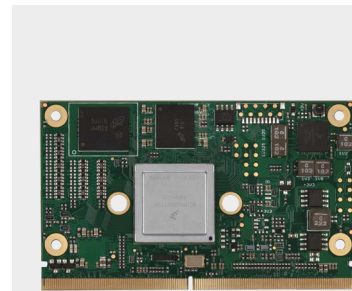
Das i.MX 6 Board von Sontheim basiert auf einem 314-pin MXM 3.0 Konnektor Standardabmessungen von 82 mm x 50 mm. Dies schafft äußerst kompakte, langlebige und kosteneffiziente Entwicklungsmöglichkeiten für mobile Embedded Handheld Systeme sowie kleine portable, stationäre und In-Vehicle Geräte die in verschiedensten Applikationsbereichen zum Einsatz kommen können.

Ausgelegt für kommerziellen und industriellen Temperaturbereich

Neben dem normalen ist das i.MX 6 Board auch für den erweiterten industriellen Temperaturbereich von -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$ ausgelegt. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Automotive, in der Automatisierung, der Medizintechnik sowie in weiteren Arbeitsumgebungen die nicht dem kommerziellen Temperaturbereich entsprechen und auch raue Umweltbedingungen mit sich bringen. Zudem ist auf Wunsch bereits ein Evaluation Board vorhanden.

Technische Daten

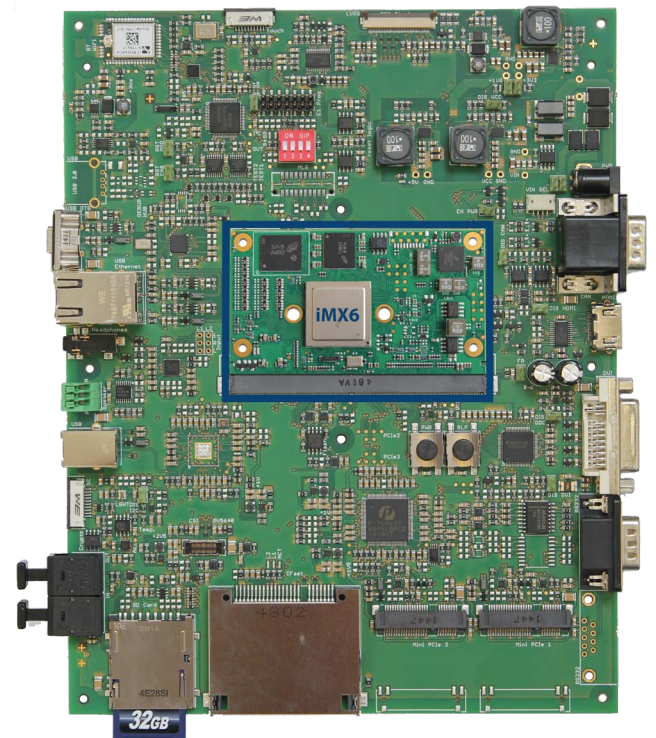
CPU	Freescape i.MX6 Single, Dual und Quad Core ARM Cortex-A9 800 MHz, 1 GHz und 1,2 GHz
Grafik	Dual Display HD 1080p encoded und decoded 2D und 3D Beschleunigung
RAM	DDR2 oder DDR3 bis zu 4 GB
Speicher	bis zu 64 GB NAND/eMMC on-module (kundenspezifisch)
USB	3x USB 2.0
Ethernet	10/100/1000 Mbit LAN
Display	Parallel LCD 18/24 Bit LVDS Single Channel 18/24 Bit HDMI
Image Capture Interface	2 Interfaces (PCAM, CSI)
Serielle Schnittstellen	2x RX/TX (Ser 1/3); 2x UART (Ser 0/2)
Weitere Schnittstellen	bis zu 3x PCIe, MLB150, 12x GPIOs, SDIO, SATA eMMC, 2x SPI, 5x I ² C, 2x I ² S, SPDIF WDT, 2x CAN, Batterie und System Management
Betriebssystem Support	Linux Windows Embedded Compact 7 (auf Anfrage) Android (auf Anfrage)
Betriebstemperatur	0°C bis +60°C, erweiterter Bereich: -40°C bis +85°C
Abmessungen	SMARC Standard: 82 mm x 50 mm



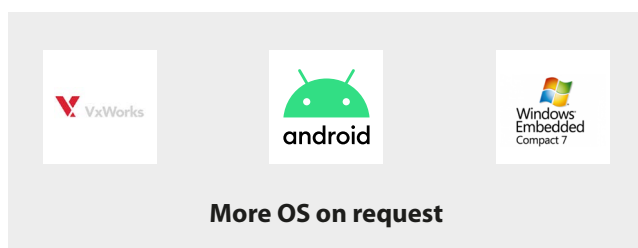
IO Eigenschaften des 314-pin MXM 3.0 Konnektors



Evaluation Board



Unterstützte Betriebssysteme





Mobile Automation



Industrial Automation



Diagnose



Connectivity

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sontheim Industrie Elektronik GmbH

Georg-Krug-Straße 2
D-87437 Kempten
Telefon: +49 (0)831 575900-0
Fax: +49 (0)831 575900-72
Email: info@s-i-e.de

Sontheim Electronic Systems L.P.

201 West 2nd Street
Davenport, IA 52801, USA
Telefon: +1 563 888 1471
Email: info@sontheim-esys.com

www.s-i-e.de